同欣電(6271 TT)

台灣股市｜電子上游

投 資 速 報

逢低買進-維持 目標價 NT$258 (潛在報酬+17.3%)

2026-09-15

受惠光通訊、車用需求成長

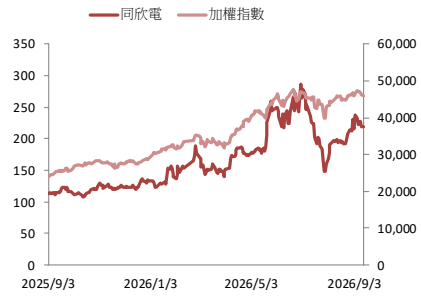
■ 結論與建議

展望 2H26~2027 年，成長動能為光通訊（800G→1.6T+ FAU）>陶瓷基板>影像感測器。預估 2027 年營收年增約 15%，現階段看起來有機會略優於該區間，主要原因 AI 帶動光纖通訊相關業務大幅成長，並預期在機台陸續進駐與驗證通過後，光通訊相關業績可望在下半年進一步放量。預估營收 3Q26 可呈現季成長，4Q26 看起來也樂觀，整體毛利率也有向上的空間，預估 2027 年稅後 EPS 11.74 元，PE 約 18.7X，考量 2027 年光通訊進入成長階段、產品結構轉強，建議逢低買進，目標價為 258 元(22*2027 年 EPS)

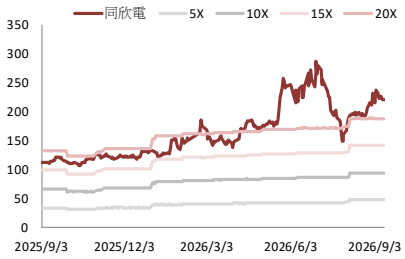
前次報告	
日期	2026/4/16
評等	逢低買進
目標價(元)	200

股價資訊	
收盤價(元)	220.00
總市值(億元)	460.0
股本(百萬)	2,091
一年高/低價	287.5 / 108
月成交均量(張)	5,143
月成交均值(百萬)	1,134.7

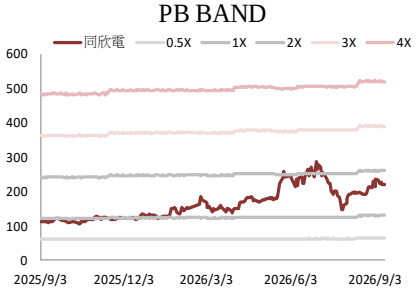
股價表現 & PE/PB



PE BAND



PB BAND



■ 重點摘要

公司簡介

公司成立於 1974 年，主要業務為陶瓷電路板製造、影像產品（含 CMOS 影像感測器封測）、混合積體電路模組、高頻無線通訊模組等。核心技術包括厚薄膜基板、直接鍍銅（DPC）製程、客製化半導體微型模組封裝與測試。產品應用於無線通訊、MEMS、影像感測器、LED、汽車電子、光電半導體、醫療、航太/衛星、光通訊等領域。近年產品結構以影像產品為最大宗（約 50%以上），其次為混合積體電路模組、陶瓷電路板、高頻無線通訊模組。應用面以車用為主（約 60%上下），其餘涵蓋工業、通訊、手機、醫療等。公司隸屬國巨集團，並透過合併勝麗國際等強化影像感測器封測能力。近年積極布局光通訊（含 400G/800G/1.6T 光模組相關陶瓷基板與封裝）等。

圖一、產品應用佔比



資料來源：同欣電、康和投顧整理，2026/9

研究員/林世忠
113034@concords.com.tw

以上資料為康和投顧所提供,不得轉寄
本公司不負任何法律責任，請投資人自行斟酌參考

光通訊產品 2026~2027 年動能強勁

RF 高頻無線通訊模組 2Q26 占營收約 13%，光通訊與低軌衛星各約一半。第二季光通訊相關產品季增約 17%，是當季成長幅度最大的產品線之一。26F 預估 RF 模組列為全年四大產品線成長性第一位，以光通訊為核心引擎，預期光通訊營收比重明顯擴大。下半年動能更強（800G 放量），相關業務年增率估達約 100%。

主要產品布局：

光纖通訊模組：與客戶長期合作（從 100G / 400G 一路推進），是主要競爭優勢。800G 產品已於 2026 年進入量產，單價提升有利毛利。目前製程良率持續改善，第一套設備經驗已導入新設備；第二台採用全自動對位（Active Alignment）設備即將進廠驗證，若順利，後續設備將全面自動化，提升效率與產能。1.6T 仍持續與客戶共同開發，進度符合預期。

FAU（Fiber Array Unit）光耦合技術：主要是 800G/1.6T 光模組中的光纖陣列及主動對位製程，應用於 NVIDIA Scale Across 長距離（50-80 公里）資料中心 DCI（Data Center Interconnect）架構，技術門檻高、附加價值大，預期成為 2H26~2027 年重要貢獻。

LEO 產品:主要利用既有的高頻 RF 封裝 + 陶瓷基板 + 高可靠度模組封裝能力切入衛星通訊。近期因產品趨於成熟化與降價，公司採維持平穩策略，將資源聚焦於更高毛利的新創產品。

陶瓷基板穩定貢獻

陶瓷電路板（含 DPC/AMB 等）2Q26 占整體營收約 19%，表現穩健。26F 陶瓷基板將為全年成長性第二位（僅次於 RF 模組）。2Q26 已年增，下半年新增訂單發酵（雷射封裝+AI 散熱），預期貢獻更明顯。與 RF 同為公司上修全年營收展望的主要助力，菲律賓新廠擴建也將強化陶瓷產能（目前菲律賓廠營收占比約 30%，未來比重續增）。

車用產品:廣泛應用於車用高功率模組、高亮度車頭燈/日行燈、車用引擎(抗酸鹼高硫化物環境），26 年有新客戶進來，27F 營收 5~10%年增。

HVDC 高功率應用：雷射與散熱陶瓷基板需求強勁，比重持續提升。切入高壓直流（HVDC）電力架構，開發氮化矽等高導熱材料（線寬可達 20 微米），新一代 AI 相關基板預計 2H26 量產，月出貨規模已達約 20 萬片。

目前的 AlN 雷射 Submount 採 PVD 製程，在陶瓷上沉積高精度金錫合金；公司揭露的產品熱傳導係數可達 230 W/m·K，並支援單顆雷射二極體約 35– 42W 功率，27F 營收 YOY+45%~55%。

受惠 RF/光通訊及陶瓷基板帶動，預估 2027 年營收持續成長

2Q26 營收 31.53 億元(QOQ+11.8%、YOY+6.3%)，成長動能主要來自光通訊相關、陶瓷基板與影像感測器等產品線的強勁表現，毛利率 31.1%，較前一季提升約 3.1 個百分點、年增約 4.5 個百分點，優於預期，受惠產品

組合改善與產能利用率提升，稅後 EPS 2.49 元。

四大產品表現，高頻無線通訊模組(占 13.5%)營收 4.07 億元(季增 16.9%、年增 10.6%)；混合積體電路模組(占 16%)營收 5.05 億元(季減 7.6%、年減 15.8%)；陶瓷電路板(占 19%)營收 6.03 億元(季增 15.6%、年增 16.4%)；影像產品(占 51%)營收 16.16 億元(季增 16.1%、年增 16.7%)。

菲律賓新廠:新增廠房面積約 2.6 萬平方公尺，相較既有約 2 萬平方公尺產能，整體產能面積將提升約 130%，產能將聚焦陶瓷基板與車用及工業應用產品，並同步支援光通訊與影像感測器業務成長，設備陸續導入(已有第 1 台手動、第 2 台半自動約 8– 9 月進，預計到 2027 年底約 8 台)。

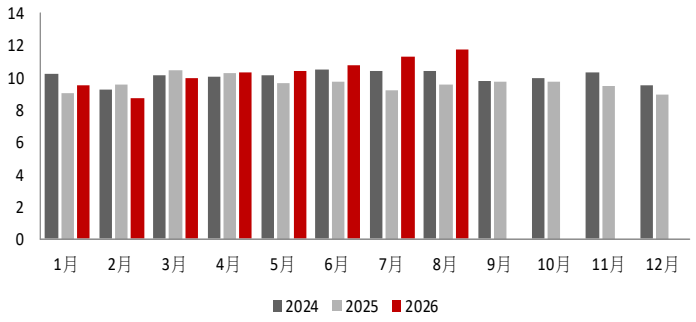
整體來看，2026 年 1~8 月營收 82.76 億元，YOY+6.75%，公司對 2026 年營運展望樂觀，整體營運已恢復疫情前季節性走勢。預期 3Q26 營收將較第 2Q26 成長「中個位數百分比」，毛利率有望進一步朝 30– 35%目標邁進。光通訊仍是成長最快的產品線(800G 光收發模組已穩定量產，並打入北美大型雲端服務供應商 / CSP 供應鏈，製程良率持續改善，自動化設備導入中；1.6T 仍與客戶共同開發)。陶瓷基板受車用 LED 需求優於預期，以及 AI 資料中心雷射應用帶動；影像感測器亦可望持續增溫。預估 2027 年營收為 144.44 億元，YoY+15%，毛利率略增至 32%，稅後淨利為 24.55 億元，YOY+21.7%，稅後 EPS 為 11.74 元。

	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
營收(百萬元)	2,818	2,819	3,153	3,311	3,278	11,543	12,560	14,444
QOQ(%)	(1.1)	0.0	11.8	5.0	(1.0)	-	-	-
YOY(%)	(5.5)	(3.1)	6.3	16.2	16.3	(4.5)	8.8	15.0
毛利率(%)	28.9	28.0	31.1	31.3	31.0	27.6	30.4	32.0
營業利益率(%)	14.3	14.0	18.1	18.3	18.0	13.9	17.2	19.0
稅後淨利(百萬元)	467	394	520	562	541	1,597	2,018	2,455
QOQ(%)	(2.2)	(15.6)	31.9	8.1	(3.8)	-	-	-
YOY(%)	23.2	(32.3)	639.6	17.7	15.9	(6.8)	26.3	21.7
EPS(元)	2.23	1.89	2.49	2.69	2.59	7.64	9.66	11.74

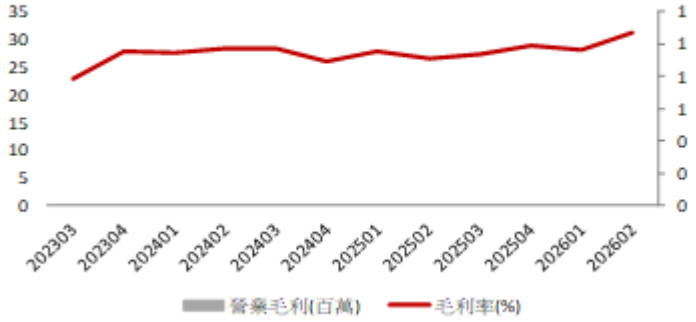
EPS以股本209.1百萬股計算

本公司不負任何法律責任，請投資人自行斟酌參考

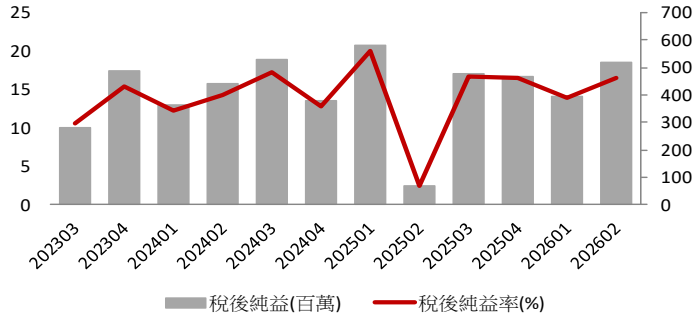
近三年營收狀況(億)



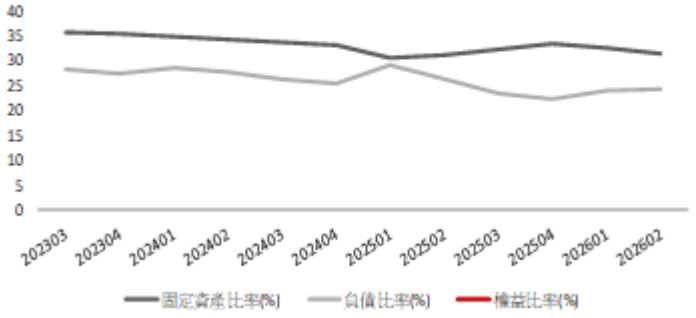
近12季_營業毛利 & 毛利率



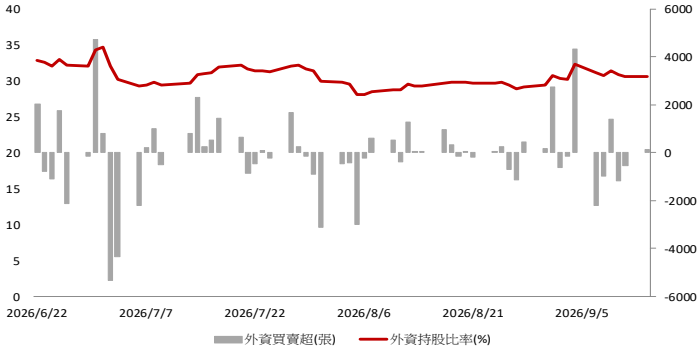
近12季_稅後純益 & 稅後純益率



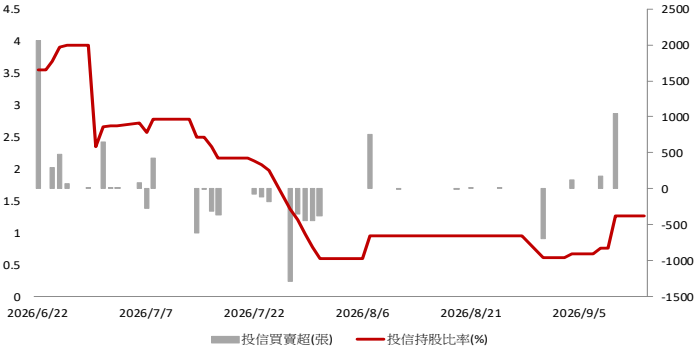
近12季_固定資產比率 & 負債比率 & 權益比率



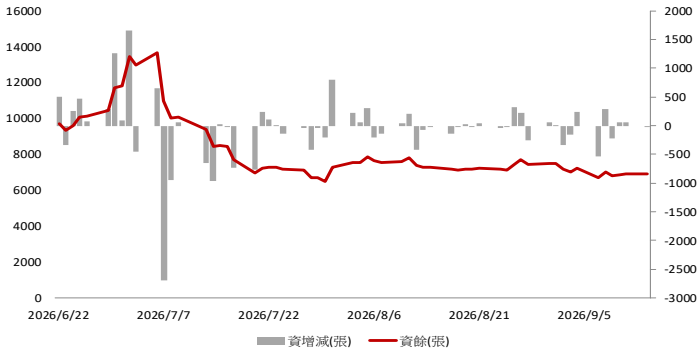
外資_持股比例 & 買賣超



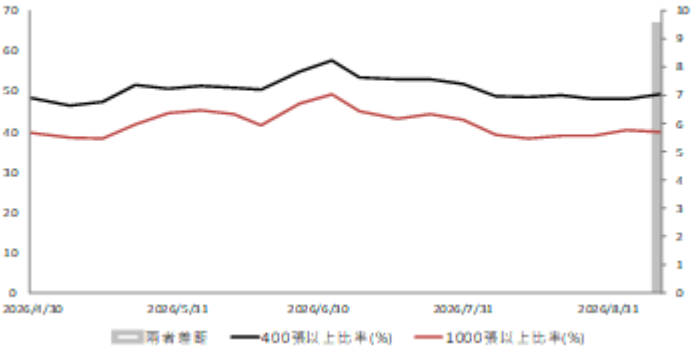
投信_持股比例 & 買賣超



融資餘額 & 資增減



近20周持股400張 & 1000張以上比例變化



評等說明

1) 強力買進/Strong Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 50%
2) 買進/Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 25%
3) 逢低買進/Trading Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間小於 25%
4) 未評等/Not Rated：至目前我們沒有足夠基本資料判斷該公司評等；或此期間康和與該公司有特定交易，基於規範或康和政策，限制予該公司評等

免責宣言:

本投資報告內容屬康和投資顧問股份有限公司版權所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本研究報告所載內容，純屬研究性質，所載述意見可隨時予以更改或撤回並不另行通知，僅提供康和集團內部同仁及客戶參考，文中所載資訊或任何意見，不構成(且不應解釋為)在任何司法管轄區內，任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。報告內容所提及之各項業務、財務等相關資訊、意見及預估，係取材自據信為可靠之資料來源，既不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性做出任何陳述或保證，且報告係基於特定日期所做之判斷，有其時效性限制，如有變更，本公司將不做預告或更新。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。